

比特大陆|算能 2023 届联合校园招聘简章

一、探索比特大陆，算力赋能未来

比特大陆的产品主要应用于区块链领域。目前，**我们在全球多个国家和地区，拥有超过10个研发中心。**为了实现“聚焦算力芯片，让人类数字世界更美好”愿景，公司多年来已经积累了完全自主控制的芯片设计队伍、设计流程与知识产权，并且长期在全球范围内挖掘人才。总体来看，在公司近千名员工中，研发人员的比例约50%，许多员工拥有在全球最顶级集成电路企业工作十年以上的经验。受益于国家良好的营商及人才环境，比特大陆已经成长为全球领先的算力芯片公司。**从全球市场来看，我们是全球第四大芯片设计公司。按收入计算，我们已经是中国排名第一的芯片设计公司。**在区块链服务器领域，自2015年以来，我们一直保持着全球市场份额第一的成绩。未来，比特大陆还将长期聚焦算力芯片，力争成为全球最先进的算力芯片公司，继续为中国的集成电路行业添砖加瓦。

算能致力于成为全球领先的通用算力提供商。算能承续了比特大陆在 AI 领域沉淀多年的技术、专利、产品和客户，专注于人工智能芯片以及相关产品的研发与推广应用。旗下拥有“算丰”“晶视”两大品牌，以自研芯片为核心打造覆盖“云、边、端”全场景算力产品矩阵，为城市大脑、智算中心、智慧安防、智慧交通、安全生产、工业质检、智能终端等应用提供算力产品及整体解决方案。公司在北京、上海、深圳、青岛、厦门等国内 10 多个城市及美国、新加坡等国家设有研发中心。

二、体验双向奔赴的美好和酷炫

管理机制扁平有序，工作氛围平等轻松，开放包容。追求“精益求精，客观优秀”的企业文化。

这里有无边界的舞台让你快速成长，你既可以深度钻研热爱的技术领域，得到专业能力的成长和技术水平的提升；又可以无限尝试，寻找自己更擅长的空间；**我们有信心让理工科专业的优秀毕业生六个月掌握 IC 设计的基本技能。**



精益求精，客观优秀

三、让你不能拒绝的薪酬福利

比特大陆采用市场领先型薪酬策略，为员工提供全方位，有温度的福利保障计划。

- 1、薪资：高于市场平均水平 50% 的薪酬待遇，研发类应届硕士平均年薪 50 万起，非研发类应届硕士平均年薪 35 万起，上不封顶；
- 2、福利：意外险，配偶子女补充商业保险，员工个人全方位医疗、意外、重疾、基金类保障；
- 3、住房：公司为大家提供 3 年免费的员工宿舍、自如为比特大陆定制“优享安居计划”；
- 4、差旅：市内外出差可享受便捷的企业用车服务，公司专用差旅平台订票，方便快捷无需垫付；
- 5、免费健身房：广阔的室内健身房+专业的健身器材+志同道合的小伙伴；
- 6、员工俱乐部：现有健身、乒乓球、台球、瑜伽俱乐部，定期举办活动，更多俱乐部持续解锁；
- 7、暖心的节假日、生日礼物：每个节日里都能收到公司定制的祝福礼物或购物卡。

	 薪 高于市场平均水平50%左右的薪资待遇
	 医 五险一金 + 补充医疗保险全面健康保障
	 食 工作日餐补+ 水果 + 各种饮料全天不限量供应 + 加班晚餐，美味又营养
	 住 3年免费宿舍+ 自如网为比特大陆定制的“优享安居计划”，住得省钱又放心
	 行 班车 + 商务出行，出差加班等可以使用企业滴滴，省去报销烦恼，送你安全抵达 贴心又便捷
	 学 培训 + 导师 工作成长两不误
	 乐 定期文体活动 + 季度团建 + 年度旅游 + 生日&节日礼物 工作也可以很快乐

四、校招职位汇总

海内外研发类、职能类职位虚位以待，期待你的加入~

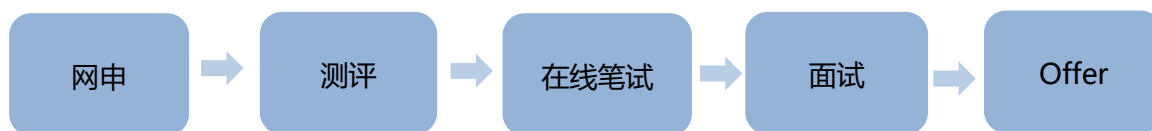
针对 2022 届、2023 届应届本科生/研究生/博士生的岗位如下：

岗位	方向	需求数量	学院/专业
数字芯片设计工程师	前端	76	数学类/物理学类/电子科学与技术类/微电子类/信息与通信工程类/计算机科学与技术类/材料科学与工程类等
	验证		
	后端		
	STA		
	DFT		
	CAD		
	PE		
	ATE		
模拟芯片设计工程师	模拟芯片设计	10	数学类/电子科学与技术类/微电子类/信息类/计算机科学与技术类
	定制电路设计		
半导体工艺工程师	半导体工艺	2	数学类/物理学类/电子科学与技术类/微电子类/信息类/计算机类/材料科学与工程类
嵌入式软件工程师	嵌入式	80	计算机科学与技术类/电子科学与技术类/信息与通信工程类/数学类/物理学类
应用软件工程师	前端	22	信息与通信工程类/机械工程类/电气工程类/电子科学与技术类/计算机科学与技术类/软件工程类专业/信息安全/网络空间安全/心理学/经管
	后端		
	客户端		
	信息安全		
	测试开发		
算法工程师	算法	26	计算机/软件工程/人工智能/电子信息、自动化等
硬件电路工程师	硬件电路	30	电子科学与技术类/信息与通信工程类/计算机科学与技术类/物理学类/数学类
热设计工程师	热设计	4	热能类/流体力学类/热工控制类/工程热物理类
结构设计工程师	结构设计	5	机械工程类/自动化类/精密仪器类
工业工程师	工业工程	3	工业工程
财务专员	财务	12	财务管理/会计/税务/经管/金融/统计等相关专业
	税务		

精益求精，客观优秀

法务专员	法务	5	法律
海外销售工程师	销售	15	社会学/经济学/金融学/工商管理/英语/市场分析等
AI 销售	销售	100	不限

五、招聘流程



(非研发类岗位无需笔试)

六、投递路径

网申地址: <https://jobs.bitmain.ourats.com/reg/campus-index>

扫码投递:



★联系邮箱: hr@bitmain.com

★具体企业信息请访问公司官网: <https://www.bitmain.com.cn/>

★公司地址:

北京: 北京市海淀区丰豪东路 9 号院 1 号楼/北京经开区信创园 B 区 8 号楼 (经济技术开发区科谷一街 10 号院)

深圳: 深圳市宝安区福海街道会展湾云岸广场 T10 栋

成都: 成都市高新区天府四街 158 号 OCG 国际中心 B 座 26 层

上海: 上海市浦东新区申江路 5005 弄星创科技广场 2 号楼 901

青岛: 青岛市城阳区上甲绿天使创业园大厦一层 111/118 号

南京: 南京市江宁区天元西路 59 号 2 号楼中南谷南京创新中心 3 层 310、322 室

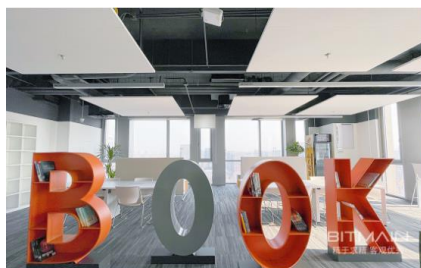
福州: 福建省福州市闽侯县福州大学国家大学科技园 2 号楼 5 层/福建省福州市长乐区数字产业园二期 8 层

厦门: 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 9 号兴汇楼 702-01

武汉: 湖北省武汉市洪山区关山大道泛悦城 T2 写字楼 2108 室

精益求精, 客观优秀

七、公司环境



精益求精，客观优秀

附：岗位介绍

1、数字芯片设计工程师

岗位职责：

- 1.负责先进工艺下数字 ASIC 芯片、AI 加速芯片、CPU 的设计研发；
- 2、编写各种设计文档和标准化资料，执行公司的开发流程、规范和制度；
- 3、工作任务包括但不限于：
 - 3.1 芯片前端设计、实现、功能验证、FPGA 原型开发与验证等；
 - 3.2 芯片中端设计 DFT、STA、芯片测试及量产等；
 - 3.3 从从门级网表到 GDSII 的后端物理实现，包括 PR，IR 分析，时序收敛等。

岗位要求：

- 1、专业包含但不限于数学类/物理学类/电子科学与技术类/微电子类/信息与通信工程类/计算机科学与技术类/材料科学与工程类应届毕业生或毕业一年内海外留学者，硕士及以上学历；
- 2、学习成绩优秀，对新生事物及专业相关领域知识具有极强的好奇心、学习能力和知识迁移能力；
- 3、了解 IC 开发流程，具备一定的数字电路理论基础和动手能力以及创新能力。

分配方向：

IC 前端、验证、PD、STA、DFT、CAD、ATE、PE

工作地点：

北京、上海、成都、武汉、青岛、厦门、新加坡

2、模拟芯片设计工程师

岗位职责：

- 1、负责模拟/混合电路方案规划与设计实现、性能优化、仿真验证及测试相关工作；
- 2、负责先进工艺下高性能、超低电压定制电路设计，针对特定 PPA 需求，能够从晶体管的选择，版图效应分析，单元逻辑合并简化，等底层优化思维出发，交付可以集成的数字单元或模块；
- 3、工作任务包括但不限于常用模拟芯片或 IP 设计，晶体管级电路设计与仿真、版图规划与设计、时序库特征化提取、SRAM 定制设计。

岗位要求：

- 1、专业包含但不限于数学类/物理学类/电子科学与技术类/微电子类/信息与通信工程类/计算机科学与技术类/材料科学与工程类应届毕业生或毕业一年内海外留学者，硕士及以上学历；
- 2、良好的半导体工艺、集成电路设计相关基础知识；
- 3、熟悉模拟、混合信号集成电路设计、了解 OPAMP/ADC/PLL/LDO/Memory 电路设计中的一种或几种者优先；
- 4、学习成绩优秀，对新生事物及专业相关领域知识具有极强的好奇心、学习能力和知识迁移能力。

分配方向：

模拟芯片/IP 设计、全定制电路设计、Library Characterization、SRAM 定制设计、版图设计

工作地点：

北京、上海、成都、新加坡

3、半导体工艺工程师

岗位职责：

- 1、负责芯片先进工艺制成的定制整合，根据设计需求 DTCO 定制工艺，实现功耗、性能的优化能力；
- 2、负责定制工艺的 SPICE Modeling 和 S2S 分析与校准；
- 3、根据需求和 Silicon 数据，负责先进工艺、先进器件结构的 TCAD Deck 以及 PDK 构建与校准；

4、负责 WAT/量产良率等 Silicon 数据的分析与处理，以此提升产品的性能和良率。

岗位要求：

1、专业包含但不限于数学类/物理学类/电子科学与技术类/微电子类/信息与通信工程类/计算机科学与技术类/材料科学与工程类应届毕业生或毕业一年内海外留学者，硕士及以上学历；

2、学习成绩优秀，对新生事物及专业相关领域知识具有极强的好奇心、学习能力和知识迁移能力；

3、具备优秀的科研经验及能力。

分配方向：

工艺工程师、Spice Modeling 工程师、PDK 工程师、TCAD 工程师

工作地点：

北京、上海、成都、新加坡

4、嵌入式软件工程师

岗位职责：

1、负责 Linux 嵌入式系统固件开发和移植，以及系统软件开发和维护；

2、负责各外设模块的驱动程序开发和维护以及内核优化、系统稳定性、系统安全等相关的底层软件开发；

3、负责芯片 SDK 的开发，包括设备驱动和内核，以及多媒体和图像处理相关模块；

4、工作内容包括但不限于嵌入式软件开发，芯片的系统级调试、测试工作，嵌入式系统软硬件相关问题的分析与定位。

岗位要求：

1、通信、电子、计算机等相关专业，本科（特别优秀者）及以上学历，具有一定的电子电路知识；

2、熟悉 Linux 系统，具有嵌入式软件设计开发基础；

3、具备较强的 C 或 C++编程能力。

工作地点：

北京、成都、深圳、青岛、厦门

5、硬件电路工程师

岗位职责：

1、产品的电路系统的原理性评估，设计和测试验证；

2、完成或者配合 CAD 设计工程师完成 PCB 的 Layout 设计；

3、解决产品研发及量产阶段的硬件技术问题。

岗位要求：

1、电子、通信、控制、自动化、电磁场与微波等相关专业本科及以上学历；

2、具备良好的模拟电路、数字电路、电磁场与微波、信号处理的基础；

3、具备单板硬件设计、实现、调试的经验。

工作地点：

北京、青岛、深圳、武汉

6、结构设计工程师

岗位职责：

1、完成产品系统架构设计部分的工作，与热设计，电路设计的同事共同设计系统最优化的产品；

2、解决产品量产中结构设计的相关问题；

3、新材料，新技术，新工艺的研究和改进；

4、了解市场与行业状况，收集、分析市场上友商同类型产品信息，并定期输出分析报告。

岗位要求：

1、机械工程、机械及其自动化、精密仪器、自动化等相关专业；
2、熟练掌握塑胶件、钣金件及机加件的设计，具备材料、加工工艺、表面处理、可靠性等方面专业知识；

3、清晰的逻辑思维能力，善于分析和解决问题，良好的理解沟通能力。

工作地点：

北京、深圳

7、热设计工程师**岗位职责：**

- 1、负责产品开发中整机及散热部件热仿真评估、散热器设计及模具开发、风扇选型、热测试等；
- 2、解决实验室及产线的热设计相关问题；
- 3、散热新材料和工艺的研究及导入。

岗位要求：

1、热能、流体力学、热工控制、动力工程、工程热物理、低温与制冷等相关专业；
2、有比较扎实的热设计理论基础，掌握热仿真工具（FLOTHERM/ICEPAK）及结构设计软件(CAD/PROE)等；
3、非常清晰的逻辑思维能力，非常强的理解沟通能力。

工作地点

北京、深圳、武汉

8、应用软件工程师**岗位职责：**

- 1、负责企业信息化系统及新型项目的产品方案设计和落地实施；
- 2、负责企业信息化系统及自研产品的安全测试和日常告警分析；
- 3、负责企业信息化系统的开发方案设计和功能实现，包括但不限于 PC、H5、客户端系统实现；
- 4、工作任务包括但不限于架构设计、软件后端/前端代码开发、软件测试开发、项目交付支撑等。

岗位要求：

- 1、应届毕业生或毕业一年内海外留学者，硕士以上学历，对最高学历不设限制；
- 2、熟练掌握 Java、C/C++、JavaScript 等编程技能，扎实的编程基础；
- 3、了解常用的数据结构和算法，了解软件开发流程，了解前端/移动端/后端开发技术中的一种或多种。

分配方向：

后端开发、前端开发、客户端开发、测试开发、信息安全工程师

工作地点：

北京、上海、南京、武汉、青岛、厦门

9、工业工程师**岗位职责：**

- 1、运用 IE 工具及方法提升制造现场效率，降低制造成本，提供效率成本解决方案；设计和建立符合精益思想的制造体系；
- 2、根据市场计划及订单交付需求，组织制造资源能力规划及建设，对 EMS 工厂进行设备产能评估，制定产能需求解决方案，落实并监控资源的有效利用，保障交付需求；
- 3、指导 EMS 工厂内部生产和辅助设施规划，产品线功能布局等设施规划任务；负责场地资源规划、管理、协调及改善优化，并提供场地解决方案；

- 4、负责生产制造费用预算管理、成本效率改进项目推动，建立高效的成本改善体系；
- 5、结合供应链制造业务发展，主导推动仿真优化新技术研究和开发引进、制造系统方案仿真优化评估等；主导生产制造体系的系统优化和制造模式设计，推动产品全制程生产工艺优化与效率提升。

岗位要求：

- 1、工业工程相关专业（机械工程专业/管理科学与工程），研究方向以人因与效率工程、供应链管理、设施规划与物流分析、质量与可靠性工程、精益生产等为主，博士研究生学历；
- 2、熟悉 IE、6Sigma 等专业知识，在精益生产、系统改善、工艺优化、效率提升、制造成本控制、智能制造、工业 4.0 等课题上有项目研究成果或核心期刊论文发表；
- 3、具有项目管理的专业知识及流程优化方法论知识。熟悉 IE 七大手法，可熟练使用 CAD 工程制图、Office 办公软件，掌握 LEAN、6sigma 及仿真等工具优先。

分配方向：

PE、SQM

工作地点

北京、深圳

10、算法工程师**岗位职责：**

- 1、深度学习编译工具链开发，将深度学习模型高效地映射到张量处理器中运行；
- 2、深度学习模型量化工具的开发优化；
- 3、在自研芯片上移植主流或客户的算法模型，编写全流程 demo，为客户提供典型场景通用技术解决方案；
- 4、评测并优化模型前后处理及全流程应用的性能；
- 5、支持客户完成算法移植工作，搜集反馈问题和需求，并提出针对公司软硬件产品的改进意见。

岗位要求：

- 1、有深度学习相关算法研究或开发经验，对算法研发工作有浓厚的兴趣；
- 2、熟练掌握 C/C++、Python 编程技能，有扎实的编程基础、良好的编程风格。

加分项：

- 1、熟悉编译器基本知识，了解至少一种通用或者专用的编译器，如 GCC、LLVM、TVM、MLIR 或者自研编译器等；
- 2、有复杂算法（如图像与视频处理、计算机视觉等）CUDA/OpenCL/汇编级优化经验；
- 3、熟悉 Caffe/TensorFlow/MxNet/PyTorch 等至少一种深度学习框架；
- 4、熟悉图像分类、目标检测及跟踪、图像分割、自然语言处理等常见深度学习算法；
- 5、熟悉图像和音视频相关基本知识，有 FFmpeg、OpenCV、gstreamer 等开发经验。

分配方向：

工具链开发、算子开发、模型移植、算法开发、程序优化、通用框架软件开发

工作地点：

北京、上海、深圳、厦门、武汉、成都、青岛

11、财务专员**岗位职责：**

- 1、会计核算政策制定及执行；财务内控执行及数据管理；财务相关的流程设计；
- 2、全球税务筹划、全球税务合规执行、税务检查应对；
- 3、预算编制及跟踪管控；对公司项目进行经济性分析，编制财务管理报表以支持公司业务，优化资源配置，提高运营效率。

岗位要求：

- 1、高度责任感和职业操守，原则性强，执行力强，思维逻辑清晰，有一定的抗压能力；
- 2、团队协作意识强，有良好的沟通能力；
- 3、学习成绩优秀，且愿意持续学习；英语能力优秀。

分配方向：

SSC 财务、业务财务、税务专员

工作地点：

北京、深圳

12、法务专员**岗位职责：**

- 1、负责公司合同管理工作，包括合同起草、审核、备案等；
- 2、负责起草标准合同模板，根据业务交易模式和交易结构的变化，提出标准合同的改进和修改建议；
- 3、制定合法的管理规章制度，审查公司规章制度的合法性和合规性；
- 4、公司运营的法律支持，包括人力资源的法律支持、知识产权的支持、公司事务法律支持、法律文件的起草和审核等。

岗位要求：

- 1、本地或海外大学本科及以上学历，法学专业；
- 2、通过全国统一法律职业资格考试的优先；
- 3、大学英语 6 级以上，英语听说读写能力优秀；
- 4、熟练使用办公软件，具有较强的文档撰写能力。

加分项：大学成绩名列前茅，学生会/社团负责人，优秀的英语水平。

工作地点

北京

13、海外销售工程师**岗位职责：**

- 1、维护和开发新老客户，完成产品销售、收款、发货等工作，保证销售目标完成；
- 2、通过与其他业务部门通力合作完成业绩目标，为客户提供全方位的服务，促进行业全生态建设，如收集和整理全球授权维修点和加盟维修点合作意向、参加与主办行业有影响力的峰会、提供产品定制化服务与合作；
- 3、主动学习产品信息，了解竞争者动向，保持对市场的敏锐度；
- 4、建立和推广品牌在行业中的正面形象和价值，不断提升品牌竞争力。

岗位要求：

- 1、本科及以上学历，专业不限，具备学生干部经验为佳；
- 2、形象气质佳，具有良好的沟通能力及解决问题能力，以结果为导向；
- 3、具备良好的合作能力及抗压能力，能够接受长期出差；
- 4、中英文流利，中文及英文皆可作为工作语言；
- 5、具备留学经历，理解并认同中西方文化。

工作地点：

法国、乌克兰、迪拜、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚等国

14、AI 销售工程师**岗位职责：**

- 1、负责区域市场规划、拓展和销售达成；
- 2、深入了解客户需求，即时和公司反馈客户的 AI 产品需求，关于产品反馈、技术支持需求等；
- 3、品牌传播：实施公司的 AI 产品及解决方案的营销活动，对公司 AI 产品及解决方案品牌知名度的树立和提升负责。

岗位要求：

- 1、应届毕业生或毕业一年内海外留学者，本科及以上学历；
- 2、有较强的学习能力，能较快掌握公司人工智能芯片产品，并能独立拜访客户，宣介产品；
- 3、有表达欲望和较强的沟通能力，具备基础的销售理论知识，并能运用；
- 4、能接受出差，高强度的工作环境，抗压能力强，勇于接受挑战。

工作地点：

北京、上海、深圳、成都、武汉、青岛、厦门、新加坡